

請求の範囲

- [請求項1] エポキシ樹脂、
硬化剤、
アルミナ粒子、及び、
エポキシ基と反応する官能基を有さない一方で、エポキシ基と反応しない官能基を有し、前記エポキシ基と反応しない官能基がケイ素原子に結合しているか、炭素数1～5の鎖状炭化水素基を介してケイ素原子に結合している構造を有するシラン化合物
を含有する、エポキシ樹脂組成物。
- [請求項2] 前記シラン化合物の含有率が、前記エポキシ樹脂の総量に対して0.01質量%～20質量%である、請求項1に記載のエポキシ樹脂組成物。
- [請求項3] 前記エポキシ基と反応しない官能基が、(メタ)アクリロイル基、(メタ)アクリロイルオキシ基、及びビニル基からなる群より選択される少なくとも1つである、請求項1又は請求項2に記載のエポキシ樹脂組成物。
- [請求項4] 前記シラン化合物が、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシランを含む、請求項1～請求項3のいずれか1項に記載のエポキシ樹脂組成物。
- [請求項5] 前記アルミナ粒子の含有率が50体積%以上である、請求項1～請求項4のいずれか1項に記載のエポキシ樹脂組成物。
- [請求項6] さらにシリカ粒子を含有する、請求項1～請求項5のいずれか1項に記載のエポキシ樹脂組成物。
- [請求項7] 請求項1～請求項6のいずれか1項に記載のエポキシ樹脂組成物によって封止された素子を備える電子部品装置。